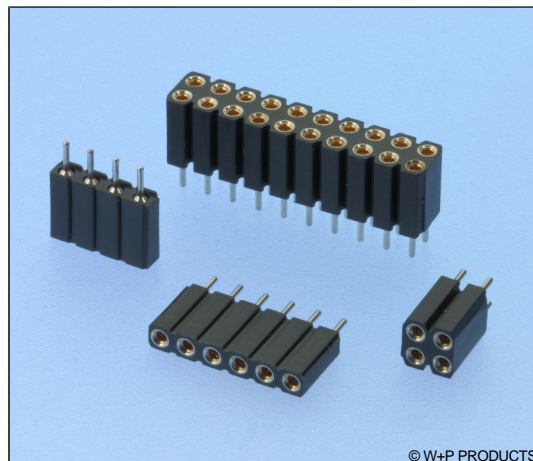


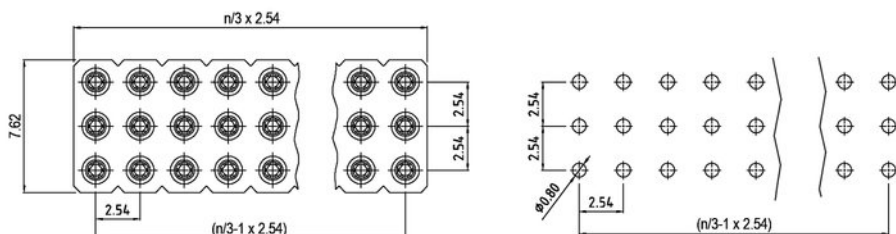
Präzisions-Buchsenleisten, RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig, BH 7mm Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double/Triple Row, 7.0mm Profile

Technische Daten / Technical Data

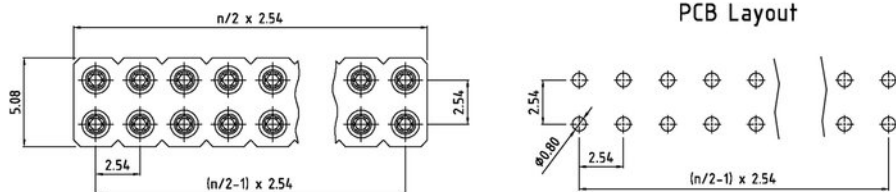
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Finger-Clip für Rundstift Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstift 0,635mm, BeCu (andere optional)
<i>Contact Material</i>	<i>Sleeve: screw machined brass</i> <i>Clip: 6-Finger-Clip for round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins, BeCu (others optional)</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC max.
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



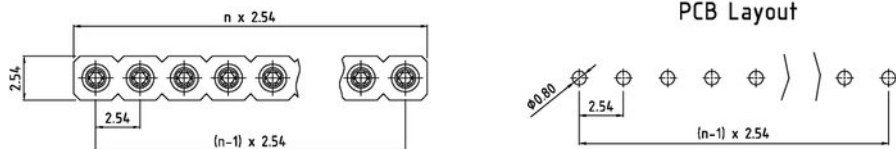
© W+P PRODUCTS



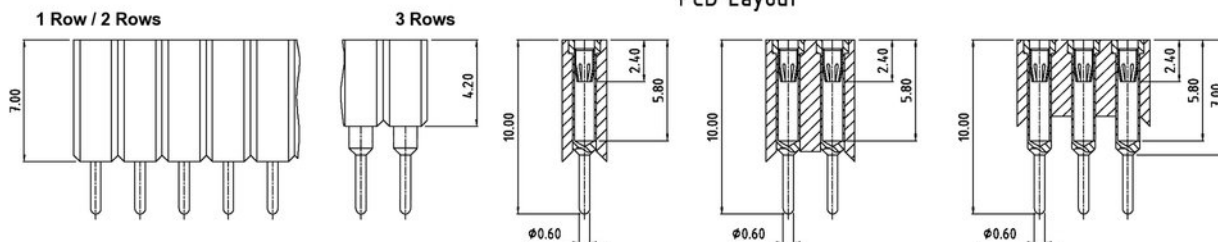
PCB Layout



PCB Layout



PCB Layout



Series	Contacts*	Rows*	Sleeve Plating	Clip Plating*	Clip (optional)*
153	020	2	50	00	..
	002-050 Einreihig <i>Single row</i> 004-100 Zweireihig <i>Double row</i> 009-096 Dreireihig <i>Triple row</i>	1 Einreihig <i>Single row</i> 2 Zweireihig <i>Double row</i> 3 Dreireihig <i>Triple row</i>	50 Hülse verzinkt <i>Tin plated sleeve</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 10 (opt.) 0,25µm Au <i>0.25µm Au</i> 30 0,75µm Au <i>0.75µm Au</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>	04 4-Finger-Clip für Rundstift Ø0,40-0,65mm oder Vierkantstift 0,25x0,45mm <i>4-Finger-Clip for Ø0,40-0,65mm round pin or 0,25x0,45 square pin</i> 09 6-Finger-Clip für Rundstift Ø0,95-1,05mm <i>6-Finger-Clip for Ø0,95-1,05mm round pin</i>

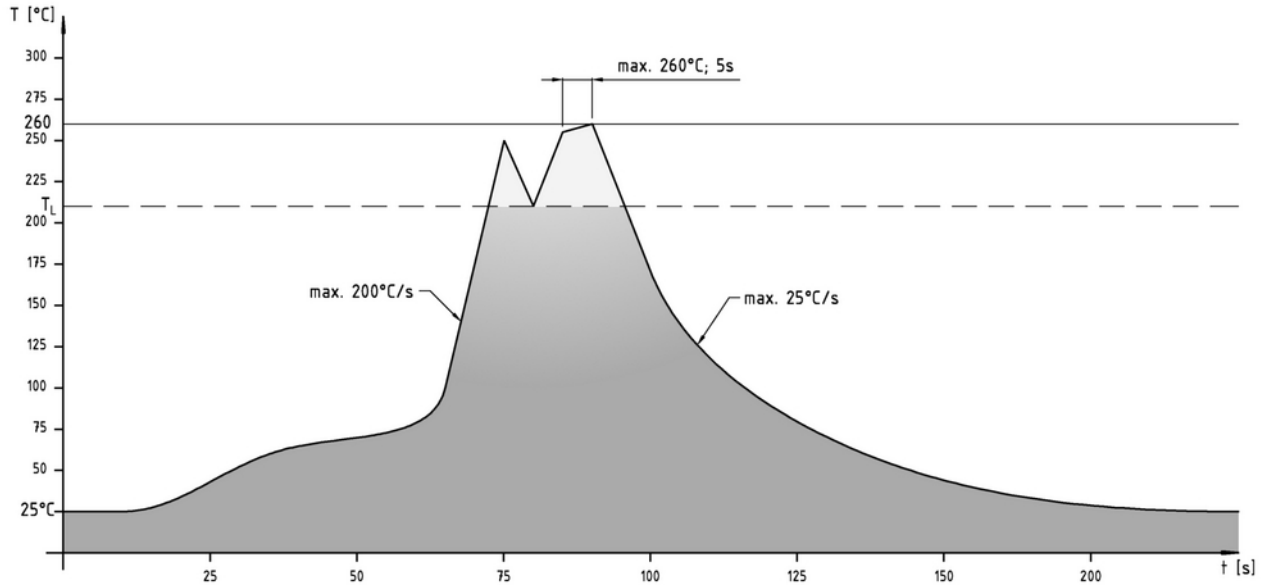
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

